

目 录

SmartPRO 6000 编程器适配器选型指南.....	1
1.1 SmartPRO 6000 系列编程器适配器命名规则.....	1
1.2 命名规则详解	1
1.2.1 厂商名称.....	1
1.2.2 适配头数量	1
1.2.3 主封装类型	1
1.2.4 引脚数.....	1
1.2.5 子封装类型	1
1.2.6 Body/Pich、PBC 编号、BOM 编号.....	2
1.3 编程器适配器的购买	2

SmartPRO 6000 编程器适配器选型指南

1.1 SmartPRO 6000 系列编程器适配器命名规则

SmartPRO 6000 编程器适配座由 8 个部分组成，详细说明如图 1.1。其中“ZY”为厂商标识；“D”为适配头数量；“S048C0”确定适配头型号，“B01”确定使用的 PCB 代号及物料 BOM 情况。

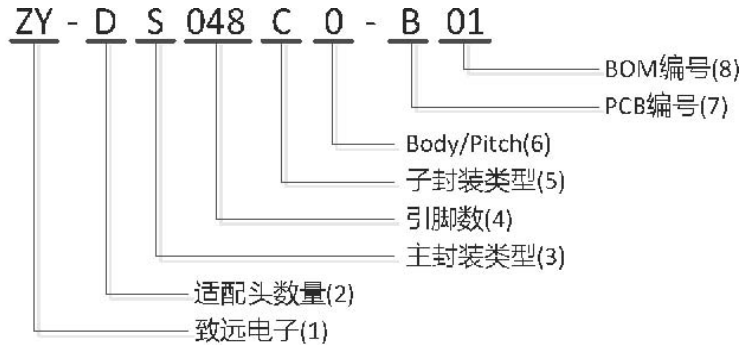


图 1.1 SmartPRO 6000 适配器命名规则

1.2 命名规则详解

1.2.1 厂商名称

厂商名称固定为 ZY，代表致远电子。

1.2.2 适配头数量

适配头数量用 A、B、C、D 分别表示 1、2、3、4，分别表示一块 PCB 上的适配头个数。由于 SmartPRO 6000 只有 1 拖 4 或 1 拖 8，所以 4 个以 ZY-A 开头（如：ZY-AB153A0-A01）的适配器搭配编程器使用；一块板上四头适配器以 ZY-D 开头（如：ZY-DB048A0-A01）搭配编程器使用。

1.2.3 主封装类型

主封装类型用来确定封装隶属于哪一个大封装类型，详细说明如表 1.1。

表 1.2 主封装类型

封装大类	代号	说明
SO	S	所有双列贴片器件，包括 SOIC、SSOP、TSOP、TSSOP、MSOP、HSOP 等
BGA	B	所有球栅阵列封装，包括 FBGA、LFBGA、TFBGA 等
QFN	N	所有方形扁平无引脚封装，包括 WSON、QFN 等
PLCC	P	所有塑料芯片载体，包括 PLCC、SOJ 等

1.2.4 引脚数

引脚数即适配器的引脚数量，示例中的“ZY-DB153A0-A01”其中的“153”代表该适配器是适配为 153 个管脚的芯片的

1.2.5 子封装类型

子封装类型显示对应封装大类下包含哪几种封装子类，详细说明如表 1.2

表 1.2 子封装分类

封装大类	代号	封装子类	代号	说明
SO	S	SOIC	A	SOIC 中包括封装宽度从 150mil 到 525mil 的多种封装
		SSOP	B	
BGA	B	FBGA	A	BGA 类都采用的是 OpenPin 的夹具，统一通过管脚数来区分
		TFBGA		
QFN	N	QFN/WSON	N	各种方形扁平无管脚的，目前主要为 SPI 接口的 Flash
PLCC	P	PLCC	P	

1.2.6 Body/Pich、PBC 编号、BOM 编号

Body/Pich 用于区分各封装的细微封装尺寸大小，不再详述。PBC 编号、BOM 编号属于厂商内部管理和生产追溯，无需细致了解。

1.3 编程器适配器的购买

以上为适配器命名规则和选型规则，购买编程器适配器的时候，请一定要与编程器软件上的型号一致。

如有疑问，请拨打技术支持电话：020-22644360 或者发邮件到 tools@zlg.cn 邮箱获取支持。